



<b>Instituto Tecnológico Argentino</b> <b>Técnico en Hardware de PC</b>	
Plan THP2A03B	Reservados los Derechos de Propiedad Intelectual
Tema: Montaje de componentes críticos	Clase N°: 8
	Archivo: GLO2A03BTHP0108.doc
Fecha: 21/8/03	Versión: 1.1

## GLOSARIO CAPITULO 8

**Buffered** - <-baferd-> chip extra dentro de un módulo de memoria para reducir la carga en las señales de entrada.

**Cutout** - <-kataut-> muesca, corte.

**Keyway** - <-kiwuei-> ranura de posicionamiento.

**Notch** - <-nach-> ranura.

**Latch Notch** - <-lach nach-> traba de ranura.

**Unbuffered** - <-anbaferd-> módulo de memoria que no tiene tecnología buffered.

**PGA** - Pin Grid Array - Pines Agrupados en Grilla.

**FC-PGA** - Flip Chip- Pin Grid Array – Chip dado vuelta con Pines Agrupados en Grilla.

**Registered** - <-reyistered-> - tecnología de buffer aplicada en memorias DDR.

**PPGA** - Plastic Pin Gris Array – igual al PGA pero con los pines insertados en la base plástica.

**SSEC** - Single Edge Contact Cartridge – Cartucho con conector de borde simple

**SEP** - Single Edge Processor – es similar al SECC pero sin la cubierta.